

Title (en)
Electromagnetic relay

Title (de)
Elektromagnetisches Relais

Title (fr)
Relais électromagnétique

Publication
EP 0869525 A1 19981007 (DE)

Application
EP 98104732 A 19980316

Priority
DE 19713659 A 19970402

Abstract (en)
[origin: DE19713659C1] An electromagnetic relay including a coil (1) encased with an insulting material in which the coil axis is parallel to the relay floor, a tiltable armature (31) arranged beneath the coil (1) parallel to the coil's axis and forming at least one working air-gap with the pole-shoes, a contact spring actuated via the armature (31) and a insulting material base (3), with the armature mounted on the base (3). A frame (4) is pushed over the base (3) and includes an enclosure for the coil (1) and a housing for the relay, the housing externally encapsulating the contact area of the relay, whereby the frame, together with the base (3), forms the bottom path of the housing and the enclosure forms the top part of the housing.

Abstract (de)
Das Relais besteht aus einer mit Isolierstoff umhüllten Spule (1), welches einen bewickelten Spulenkörper, einen Kern, Polschuhe und Wicklungsanschlüsselemente (16) umfaßt, einem schwenkbaren Anker (31), der durch ein Isolierstoff-Trägerelement mit Kontaktfedern verbunden ist, und einem Sockel (3) aus Isolierstoff, der Anschlußbahnen für feststehende Gegenkontaktelemente sowie Kontaktanschlüsselemente (34) für bewegliche und feststehende Kontaktelemente enthält. Der Anker (31) ist über Lagerstützen (35) und in die Kontaktfedern integrierte Lagerbänder (36) am Sockel (3) gelagert. Ein über den Sockel (3) geschobener Rahmen (4) bildet zusammen mit diesem und der umhüllten Spule (1) ein Gehäuse für das Relais, welches den Kontaktraum des Relais nach außen abkapselt, wobei der Rahmen (4) mit dem Sockel (3) das Gehäuseunterteil und die umhüllte Spule (1) das Gehäuseoberteil darstellt. <IMAGE>

IPC 1-7
H01H 51/22; **H01H 50/02**

IPC 8 full level
H01H 50/02 (2006.01); **H01H 50/04** (2006.01); **H01H 51/22** (2006.01); **H01H 71/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01H 50/026 (2013.01 - EP US); **H01H 50/042** (2013.01 - EP US); **H01H 51/2281** (2013.01 - EP US); **H01H 71/025** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] EP 0613163 A2 19940831 - OMRON TATEISI ELECTRONICS CO [JP]
- [DA] DE 29521012 U1 19960808 - SIEMENS AG [DE]
- [DA] DE 4408980 A1 19940929 - SIEMENS AG [DE]

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
DE 19713659 C1 19980625; EP 0869525 A1 19981007; JP H10294051 A 19981104; US 5880655 A 19990309

DOCDB simple family (application)
DE 19713659 A 19970402; EP 98104732 A 19980316; JP 8644498 A 19980331; US 5217498 A 19980331